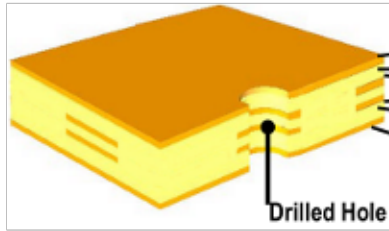


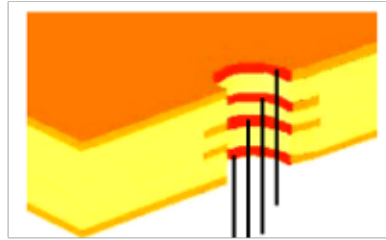
## **Perforado**

Los paneles son perforados lado a lado en donde van las vías.



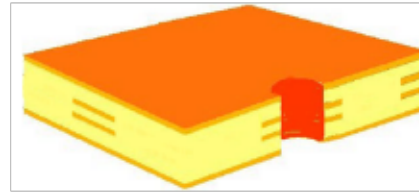
## **Desmear**

Para conseguir buen contacto entre layers y la vía se realiza una limpieza del agujero dejando libre de impurezas al cobre.



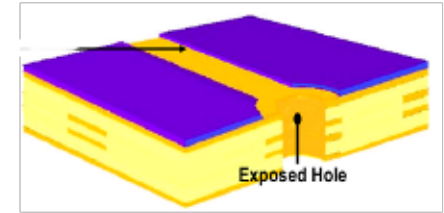
## **Metalizado**

En una serie de cubas con diversas soluciones se aplica el proceso electrolítico para metalizar la vía.



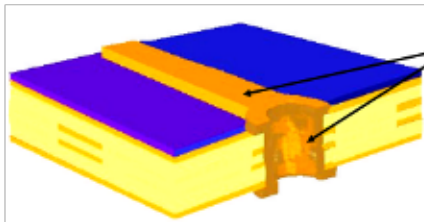
## **Imagen**

Se transfiere la imagen revelada en laboratorio con el negativo del circuito a grabar.



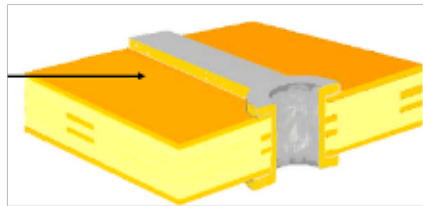
## **Engrosamiento**

Se realiza una deposición de cobre mediante electrolisis sobre la superficie sin fotopolimero.



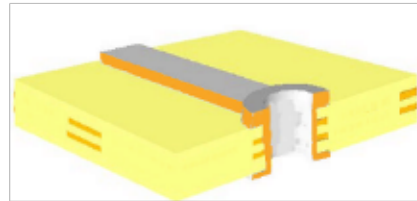
## **Estañado**

Se realiza otra capa pero de estaño para proteger el grabado.



## **Grabado**

Consiste en grabar el cobre no protegido por el estaño, colocandolo en una cuba con acidos que atacan al fotopolimero.



## **Revelado**

Por ultimo se quita ataque acido el cobre no estañado dejando asi solo las pistas del circuito impresas y las vías.

